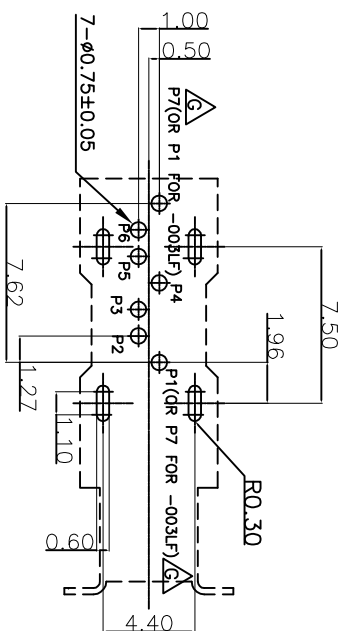
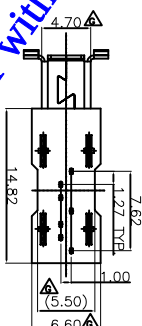
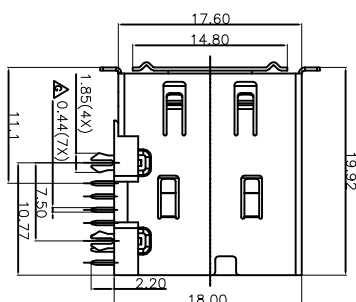
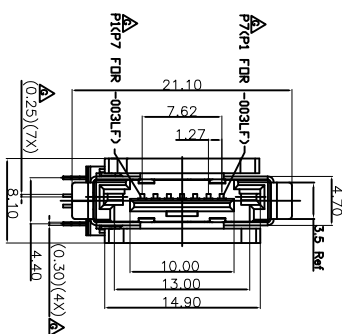


PRODUCT NO.
10074141-001LF
10074141-003LF



PIN DEFINITION

ESATA	NAME	TYPE
P1	GND	
P2	A+	
P3	A-	
P4	GND	
P5	B-	
P6	B+	
P7	GND	

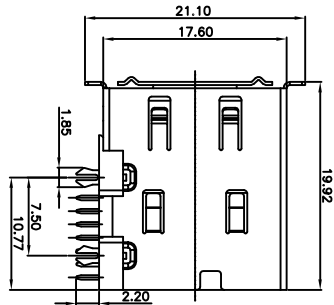
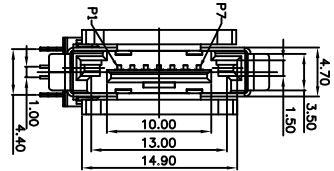
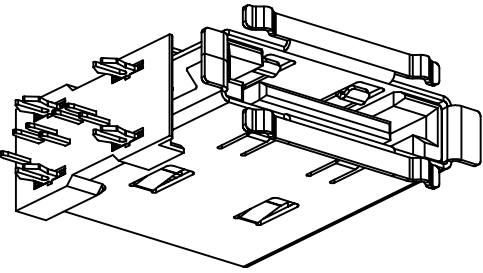
RECOMMEND P.C. BOARD LAYOUT

PCB TOLERANCE:±0.05

mat'l. code	14	surface	ISO 1302	ISO 406	ISO 101	projection	product family
lfr	ecp no	dr	date	tolerances unless otherwise specified	angle	linear	MM
A	107-1074S	LNK	2007-05-23		XX±0.38		
B	108-1082S	LNK	2008-04-28		XX±0.25		
C	110-0184S	LNK	2010-12-14	0±27	.XXX±0.100	scale 2:1	
D	1-00544QS	LNK	2011-08-31	dr	STERLING	LNK	2007-05-21
E	EX-S-007881	HKL	2011-10-17	engr	HKLIM		2016-03-03
F	EX-S-011878	HKL	2012-06-08	chr	HKLIM		2016-03-03
G	EX-S-23469	HKL	2016-03-03	dpd	KPTAY		2016-03-03
sheet	revision	G	G	107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139			
index	sheet	1	2	3	106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138		

- NOTES:
1. MATERIAL: HOUSING-THERMAL/PLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F UL94 V-0
 2. FINISH: 500" MIN. MAT TIN PLATING ON SOLDERABLES
 3. THE HOUSING WILL WITHSTAND TO 260C FOR 10 SEC IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.6MM PCB
 4. PRODUCT SPEC : GS-12-386
 5. PACKING SPEC : GS-14-1109
 6. A SYMBOL Δ WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION
- PACKING: TRAY PACKING
1. 150" GOLD PLATING
2. 0.07" GOLD PLATING
3. 150" GOLD PLATING WITH NEW PINOUT ASSIGNMENT
0. LAYOUT#1

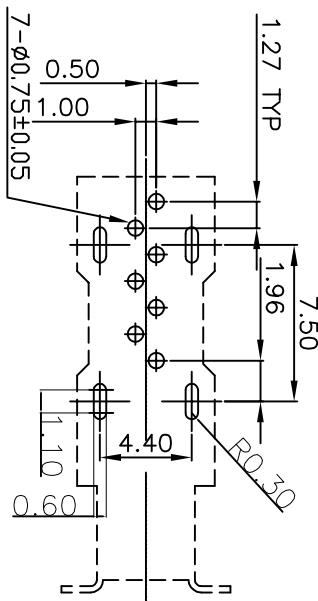
PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools



PIN DEFINITION

NAME	TYPE
P1	GND
P2	A+
P3	A-
P4	GND
P5	B-
P6	B+
P7	GND

PDFFill PDF Editor with Free Writer and Tools



P.C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS T=1.60mm
PCB TOLERANCE: ±0.05

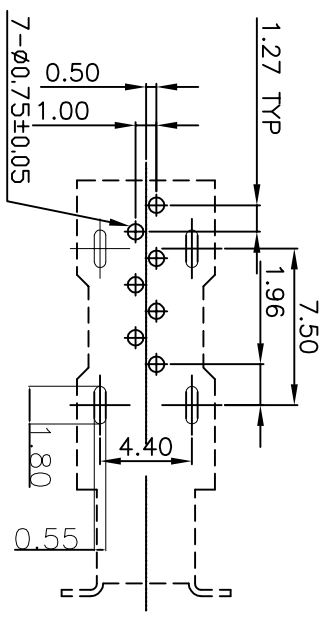
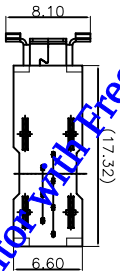
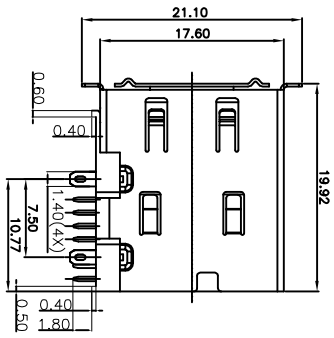
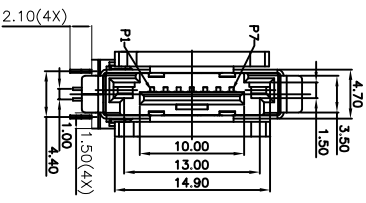
- NOTES:
1. MATERIAL:
HOUSING: THERMAL PLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F UL94 V-0
CONTACT: COPPER ALLOY
SHELL: COPPER ALLOY
COLOR: BLACK
 2. FINISH:
CONTACT: GOLD PLATING ON CONTACT AREA
SHELL: BOARD LOCK: COPPER ALLOY
100µ" MIN. WATT TIN PLATING ON SOLDERMATS
50µ" MIN. NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
BOARD LOCK: 50µ" MIN. WATT TIN PLATING OVER ALL
SHELL: BOARD LOCK: 50µ" MIN. NICKEL PLATING OVER ALL
3. IN A WIRE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5MM PCB
 4. PRODUCT SPEC : GS-12-386
 5. PACKING SPEC : GS-14-1109
 6. PRODUCT NUMBERING:
10074141 - 1 0 1 1 0 9 LF LEAD FREE
- 1: LAYOUT#2
- 1: 150µ" GOLD PLATING
2: 6/7 GOLD PLATING
6. A SYMBOL Δ WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE, WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION

mat'l. code	14	surface	sg	tolerance	projection	product family
lfr	ecn no	dr	date	ISO 1302	ISO 406	ISO 101
A	107-1074S	LN	2007-05-23	tolerances unless otherwise specified	.X±0.38	MM
B	108-1082S	LN	2008-04-28	angle	.XX±0.25	MM
C	110-0184S	LN	2010-12-14	0°±2°	.XXX±0.100	scale 2:1
D	1-00544QS	LN	2011-08-31	STERLING	LN	2007-05-21
E	EX-6-00781	HKL	2011-10-17	ENG	HKLIM	2016-03-03
F	EX-6-01179	HKL	2012-06-08	CH	HKLIM	2016-03-03
G	EX-6-25409	HKL	2016-03-03	DPD	KPTAY	2016-03-03
sheet	revision	G	G	G	107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139	type
index	sheet	1	2	3	106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138	sheet 2 of 3

E-SATA_UP_RIGHT
DIP_TYPE

Amphenol
FCI

10074141
sheet 2 of 3
size A3



P.C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS T=1.60mm

PCB TOLERANCE: ±0.05

PIN DEFINITION	
NAME	TYPE
P1	GND
P2	A+
P3	A-
P4	GND
P5	B-
P6	B+
P7	GND

- NOTES:
1. MATERIAL: THERMOPLASTIC HIGH TEMP WITH 30% G/F UL94 V-0
 2. FINISH: CONTRACT GOLD PLATING ON CONTACT AREA
 3. THE HOUSING WILL WITHSTAND TO 260C FOR 10 SEC IN A WAVE SOLDER APPLICATION WITH A 1.5MM PCB
 4. PRODUCT SPEC : 05-12-386
 5. PACKING SPEC : 05-14-1109
 6. A SYMBOL WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW OR NOTE, WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION

mat'l. code		surface sg		tolerance		projection		product family	
lfr	ecn no	dr	date	ISO 1302	ISO 406	ISO 101	MM	533	
A	107-1074S	UN	2007-05-23	tolerances unless otherwise specified	.XX±0.38			E-SATA_UP_RIGHT	
B	108-1082S	UN	2008-04-28		.XX±0.25			DIP_TYPE	
C	110-0184S	UN	2010-12-14	0°±2°	.XXX±0.100		scale 2:1		
D	1-00544QS	UN	2011-08-31	STERLING	2007-05-21				
E	EX-S-007881	HKL	2011-10-17	ENG	HKLIM	2016-03-03			
F	EX-S-011878	HKL	2012-06-08	CH	HKLIM	2016-03-03			
G	EX-S-23469	HKL	2016-03-03	QPP	KPTAY	2016-03-03			
Sheet	revision	1	2	3	107 109	111 113 115	117 119	121 123 125 127 129	131 133 135 137 139
index	sheet	G	G	G	106 108	110 112 114	116 118	120 122 124 126	128 130 132 134 136 138

PDFFill PDF Editor with Free Writer and Tools

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9